



## 厚玻璃激光加工设备

## Thick glass laser processing equipment

该设备采用高频高功率激光对玻璃材料进行切割、钻孔。高清影像对位及专业定制化的操作软件控制系统，使生产效率更高，重复定位更精确，操作更简单。该设备目前已在仪器仪表玻璃、光伏玻璃、医疗仪器、车载显示、光电显示、面板显示、家具玻璃等行业得到非常广泛的应用。

- 采用大理石精密平台，稳定承载，耐腐蚀；
- 集成高精度3D扫描头，配合高精度直线电机平台，比传统激光加工设备速度更快，质量更优；
- 标配窄脉宽(<10ns)激光器，光束质量好、加工效率高；
- 加工尺寸范围 $\phi 0.2\text{mm}-\phi 50\text{mm}$ ，玻璃厚度0.1mm-8mm；
- 崩边尺寸 $\leq 120\mu\text{m}$ ；
- 可增加自动下料机构并和测量系统形成闭环，代替人工完成OK/NG物料的分检包装作业。

主要技术参数

激光器	绿光
激光额定输出功率 (W)	8-30 (可选)
可加工玻璃厚度 (mm)	0.1-8
单次扫描范围 (mm)	50×50
可加工最小孔径 (mm)	$\phi 0.2$
崩边 (mm)	$\leq 0.12$
平台定位精度 (mm)	$\pm 0.003$
平台重复定位精度 (mm)	$\pm 0.0015$
平台移动范围 (mm)	500×550 (可定制)
最小切割线宽 (mm)	$< 0.15$
切割尺寸精度 (mm)	$\leq \pm 0.15$
设备尺寸 (mm)	1500×1300×1750
设备重量 (kg)	1600

